

# 中国半导体行业协会半导体分立器件分会

中半器协 [2016]003 号

## 第二届全国新型半导体功率器件及应用技术研讨会

为推动我国新型功率半导体器件技术水平进一步提高，加快其成果转化和应用推广，提高自主创新能力。由中国半导体行业协会分立器件分会、专用集成电路重点实验室、中国电子科技集团公司第十三研究所共同承办的“第二届全国新型功率半导体器件及应用技术研讨会”于2016年11月25日在云南昆明召开。本会议是继去年厦门成功举办后，全国新型功率半导体器件及应用领域又一次重要的学术、技术交流活动，将为广大从事新型功率半导体材料、器件及其应用技术工作者提供一个高起点、大范围、多领域的交流平台，增进产、学、研之间的技术交流，相互学习，共同提高。为此大会组委会热忱欢迎广大企业、科研院所、高等院校从事新型功率半导体材料、器件及应用技术的相关领域人员，以及相关配套应用的电子专用设备供应商共赴盛会，交流分享自己的应用经验与开发成果。

### 畅通、共享、共赢——全球化背景下的新型半导体器件及应用技术

#### 一、会议特邀报告

会议将力邀国家工业和信息化部电子信息司领导，给全体与会代表作指导性主旨演讲。还将邀请以下著名学者和专家作特邀报告：

株洲南车时代电气股份有限公司 IGBT 事业部总经理	刘国友 教授
南京大学电子科学与工程学院	陆海 教授
英飞凌科技中国有限公司工业功率控制事业部高级经理	陈子颖 先生
电子科技大学微电子与固体电子学院	李泽宏 教授
专用集成电路重点实验室	冯志红 研究员
北京天科合达蓝光半导体有限公司常务副总经理兼技术总监	彭同华 研究员
瑞士 ABB 公司半导体高级销售经理	陈马看 博士

#### 二、会议组织机构

**指导单位：**中国半导体行业协会

**承办单位：**中国半导体行业协会分立器件分会

专用集成电路重点实验室

中国电子科技集团公司第十三研究所

协办单位：合肥锐拓科技信息服务有限公司

云南妙创会议服务有限公司

《半导体技术》编辑部

《微纳电子技术》编辑部

### 三、征文范围

1. 宽禁带（GaN、SiC 等）外延材料的结构设计、制备与检测技术；
2. 功率器件用 GaAs、InP 外延材料的结构设计、制备与检测技术；
3. 基于金刚石、石墨烯的功率器件的结构设计、加工与测试技术；
4. 微波功率器件的结构设计、加工与测试技术；
5. 电力电子器件的结构设计、加工与测试技术；
6. 特种高功率半导体器件的结构设计、加工与测试技术；
7. 功率器件的封装和可靠性技术；
8. 功率器件的系统集成技术；
9. 功率器件及其系统集成的仿真技术；
10. 相关的加工、检验、测试的先进仪器与设备；
11. 功率器件及其电路在电子制造业、网络通信、消费电子、工业控制、汽车电子等领域的应用技术；
12. 功率半导体技术的知识产权保护。

### 四、论文要求

字数约 600 字论文摘要，完整表述论文的背景、论据和结论，用 A4 纸版面，Word 格式书写，注明作者单位、姓名、简历和联系方式，用电子邮件发送到会议筹备组（polaris13@vip.163.com，csiadd@126.com），文章一经收到，会务组会以邮件回复，如未收到邮件回复，请电话联系会务组予以确认。

论文详细摘要截稿日期：2016 年 10 月 16 日

论文一经录用，将立即通知作者，请作者准备相应的PPT或PDF演示文件，以备演讲时使用。其论文可以依据作者意愿在中文核心期刊、中国科技核心期刊《半导体技术》和《微纳电子技术》全文发表，免收审稿费。

### 五、会议时间和地点

- 1 会议时间：2016 年 11 月 25 日报到，26 日至 28 日开会。

2 会议地点：昆明云安会都温泉大酒店

## 六、企业形象和产品宣传

邀请国内外厂商在会议期间参与企业形象和产品的宣传，承办者将以优惠条件提供场所和服务，也可以在《半导体技术》、《微纳电子技术》刊登广告。

（第二轮会议通知将在 11 月初发出，其中将介绍会议详细安排、会议议程、论文题目及报告人等事宜。）

会议联系单位：中国半导体行业协会分立器件分会秘书处

（石家庄市合作路 113 号 中国电子科技集团公司第十三研究所）

联系人：

陆皓：13832163057；E-mail:luhao4168@vip.126.com；luhao4168@163.com

李永 电话：0311-87091519 手机：13933075237

传真：0311-87091477

电子邮件：polaris13@vip.163.com

分立器件分会信箱：csiadd@126.com

中国半导体行业协会分立器件分会

二零一六年七月一日

